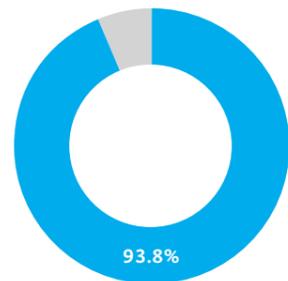


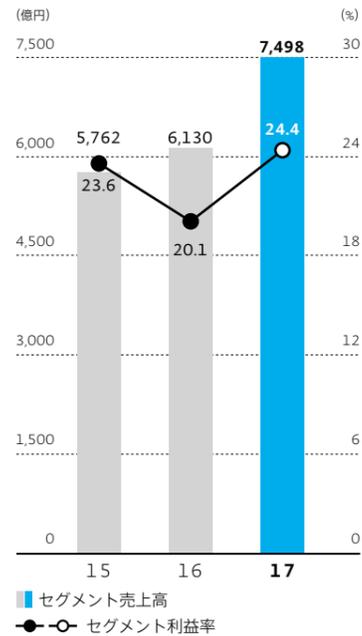
## セグメント別営業概況および事業展望

## 半導体製造装置

## ■ 売上高構成比



## ■ セグメント売上高と利益率



セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益に対応しています。

## ■ 事業環境

2016年は、IoT (Internet of Things) の到来によりスマートフォンやデータセンター向けサーバーの性能向上が進み、メモリの搭載容量の増加やロジックの高速化に対する需要が盛り上がりを見せました。これを背景に、メモリでは特に、3次元構造を採用した新たなNANDフラッシュメモリである3D NAND向けの投資が大幅に増加しました。ロジックにおいては、主にファウンドリメーカーが最先端の10ナノメートル世代に積極的に投資を行いました。これらの結果、2016年の半導体前工程製造装置 (WFE) \* の設備投資額は、全体で前年比10%以上増加のおよそ370億ドルに到達しました。

\* 半導体前工程製造装置 (WFE; Wafer fab equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

## ■ 営業概況

## ▶ セグメント売上高は前期比22.3%増加の7,498億円

- ・地域別では、NANDフラッシュメモリとファウンドリ向けの旺盛な投資を受け、主に台湾、中国、韓国の売上高が伸長
- ・装置別では、注力分野であるエッチング装置における、需要増加と市場シェアの向上が売上をけん引。成膜分野でも、最先端の微細化に対応したセミバッチALD\*\*装置の売上高が前期比2倍
- ・フィールドソリューション事業 (パーツ・中古機販売、改造・保守サービス) の売上高は、前期比12%増加の約2,080億円

## ▶ セグメント利益率は、前期の20.1%から24.4%に上昇。売上増加や工場稼働率が高水準で推移したことが寄与

\*\* ALD (Atomic layer deposition) : 原子レベルで一層ずつ膜を堆積させる成膜手法

## ■ 事業展望

IoTの到来に伴って身のまわりのあらゆるものに半導体が搭載されていくとともに、自動運転やAIの研究が実用化に向けて進んでおり、データをクラウドで即時に処理・分析できる最先端の半導体の需要が急速に拡大しています。これらの需要拡大を背景にWFE市場は400億ドル規模を超え、一段上の成長軌道に乗り始めています。当社は、とりわけ市場成長が期待されるエッチング、成膜、洗浄装置を注力分野と位置付け、技術の差別化による収益性およびシェアの向上を目指しています。

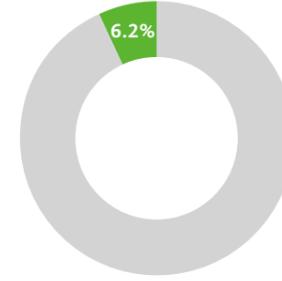
中でも3D NANDにおいては、縦方向に積層数を増やす成膜技術と、それらを高い加工精度で一度にエッチングする技術が求められています。当社は、従来から強みを持つ深穴エッチング技術をさらに磨き、NAND分野でのエッチング装置のシェアを拡大させていきます。

ロジックにおいては、エッチング・成膜技術を駆使して微細加工を実現するマルチプルパターンングによって微細化が推し進められています。当社は、高いシェアを持つエッチング装置に加えて、生産性に優れたセミバッチALD装置や、パターンの倒壊を抑制する洗浄装置を拡販することにより、収益の向上を図ります。

また、長期的には、新たな材料の採用やトランジスタの構造変化が予測され、技術的な課題はいろいろと難しく、かつ複合的なものになっていきます。こうした課題に対し、当社は豊富な製品群を有する強みを生かして、単一装置の性能向上だけでなくプロセス全体の最適化を図るソリューションをいち早く開発・提供していきます。お客様の次世代やその先の世代の技術計画に早期から参画することで、中長期的な事業成長を加速させていきます。

## FPD製造装置

## ■ 売上高構成比



## ■ セグメント売上高と利益率



セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益に対応しています。

## ■ 事業環境

2016年は、スマートフォンをはじめとするモバイル端末向け中小型パネルにおいて、従来のLCDに加えて、新型ディスプレイである有機ELの普及を見据えた設備投資が本格的に開始されました。主にこの中小型向けの投資がけん引役となり、2016年のディスプレイ設備投資は前年から大幅に伸長して100億ドルを超えました。そのうち、当社が参入するTFTアレイ工程\*向け製造装置市場は、前年比およそ3割伸長しました。

\* TFTアレイ工程 : ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

## ■ 営業概況

## ▶ セグメント売上高は前期比10.5%増加の493億円

- ・高精細のパネル向けに強みを持つ中小型向けPICP\*\*エッチング装置が複数顧客に採用され、売上が大幅に拡大
- ・大型パネル向けにも新たにPICPエッチング装置を投入し、売上を計上
- ▶ セグメント利益率は前期比1.2ポイント低下の9.4%。高収益性のPICPエッチング装置の売上が拡大した一方、第10.5世代装置の開発投資を積極的に実施
- ▶ 技術の差別化により、第10.5世代向けのビジネスを獲得

\*\* PICP : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

## ■ 事業展望

ディスプレイ市場は、今後もモバイル・テレビ向けの両方において需要の拡大が予想されており、当社は再成長する市場においてシェアと収益性の拡大を目指しています。

モバイル向け中小型パネルにおいては、画面サイズの大型化が進むとともに、高精細・低消費電力といった性能の向上やフレキシブルディスプレイなどが求められています。それらを実現する有機ELの製造においては、エッチングの難易度が高まるだけでなく、フレキシブルディスプレイの製造に伴い新たなエッチング工程が生まれると予想されています。当社は加工均一性に優れたPICPエッチング装置の拡販を順調に進めており、今後は新たなプラットフォームの採用や、新工程に対応した装置の投入により、この事業機会の拡大を着実に成長へと繋げていきます。

テレビ向け大型パネルにおいては、65インチを超える大型サイズの普及が予想され、これに対応した第10.5世代・第11世代パネルの投資が中国を中心に複数計画されています。当社は第10世代におけるコータ/デベロッパ、エッチング装置の量産採用実績を生かし、当期に獲得したビジネスに続けて、今後他の投資計画においても高いシェアの獲得を目指します。また、4K・8Kなどの高精細パネルへの投資に対応するため、中小型で実績を残しているPICPエッチング装置を大型パネル向けにも展開し始めています。

さらに、有機ELテレビの市場の立ち上がりを見据えて、当社は大型パネル向けインクジェット描画装置を新たに取り揃え、お客様の開発ラインに納入しています。既存の蒸着方式に比べて材料使用効率が圧倒的に優れるという強みを生かし、強固なポジションを築いていきます。